

2019 Investor Presentation



**Ceramics Total Solution Provider
Based on Materials Technologies**



Contents



Company Information

- ✓ Company Overview
- ✓ Board of Directors
- ✓ Brief History
- ✓ Stock Information

Business Information

Financial Information

Company Overview

회사명	(주)알엔투 테크놀로지	대표이사	이효종
설립일	2002년 3월 26일	자본금	3,278,139,500원(2019. 4. 24. 기준)
주요 사업	무선통신용 부품 다층 세라믹 PCB 소재	직원수	177명(2019. 3. 31. 기준)



본사/제1공장/기업부설연구소(경기도 화성시)



제2공장/신소재연구소(강원도 강릉시)

Board of Directors

대표이사
이 호 중

- 서울대학교 금속공학 박사
- 아멕스 신소재연구소
- MRW 테크놀로지 기술연구소

품질경영

김경오 상무

- 고려대학교 고체물리학 석사
- 라온텍 품질이사
- 인티그런트 연구소 개발팀장

영업

정건교 이사

- 울산대학교 항공우주공학 석사
- 닝보티엔리 이사

제조

육점국 상무

- 서울대학교 금속공학 석사
- 아모텍 연구소

기업부설연구소

김용석 이사

- 전남대학교 공업화학 석사
- 삼성전기

신소재연구소

손석호 상무

- 연세대학교 금속공학 석사
- 아멕스 신소재연구소
- MRW 테크놀로지 기술연구소

경영지원

정도철 상무

- 한국기술교육대학교 기술경영 박사
- 진해화학
- MRW 테크놀로지 CFO

Brief History

2002

- 03 회사 설립(파주)
- 07 기업부설연구소 설립
- 11 벤처기업 등록
- 12 ISO 9001 인증

2003

- 04 부품소재 전문기업 인증

2004

- 04 본사 이전(이천)
- 10 KT마크 신기술 인정
(과기부, LTCC Powder)
- 12 투자유치
(동양창업투자)

2005

- 06 IR52 장영실상 수상
(과기부, LTCC Powder)

2006

- 01 ISO 14001 인증
- 03 투자유치(산은 캐피탈)
- 04 본사 이전(평택)
- 06 INNO-BIZ 기업 선정

2007

- 02 NeP 신제품 인증
(산자부, LTCC Powder)
- 04 강릉 신소재연구소 설립
- 05 투자유치(산업은행)

2008

- 04 제2공장 준공
(강릉시 과학산업단지)
- 11 1백만불 수출의 탑
- 12 수출유망중소기업 지정

2010

- 09 기술보증기금 A+ 멤버
- 12 지식경제부 장관표창

2011

- 06 고용우수기업 인증
(강원도청)

2012

- 02 New Exporters 300 기업
- 07 산학협동상 특별상 수상

2013

- 11 UL인증(REP)
- 12 3백만불 수출의 탑
코넥스시장 상장

2014

- 09 산업통상자원부 장관상
- 11 본사 이전(화성 동탄)

2015

- 04 코넥스대상 최우수 경영상

2016

- 06 코스닥시장 이전 상장
- 07 기술사업화 부문 표창
(한국산업기술진흥원장)
- 09 강원과학기술대상
신소재·ICT부문(강원도지사)
- 12 일자리 우수기업 인증

2017

- 04 ICT 이노베이션국무총리 표창
- 10 유망중소기업 인증(경기도)
- 11 UL인증(REP 13종)
- 12 5백만불 수출의 탑

2018

- 03 TUV인증(REP)
- 제2공장 증설(강릉)
- 12 1천만불 수출의 탑

43

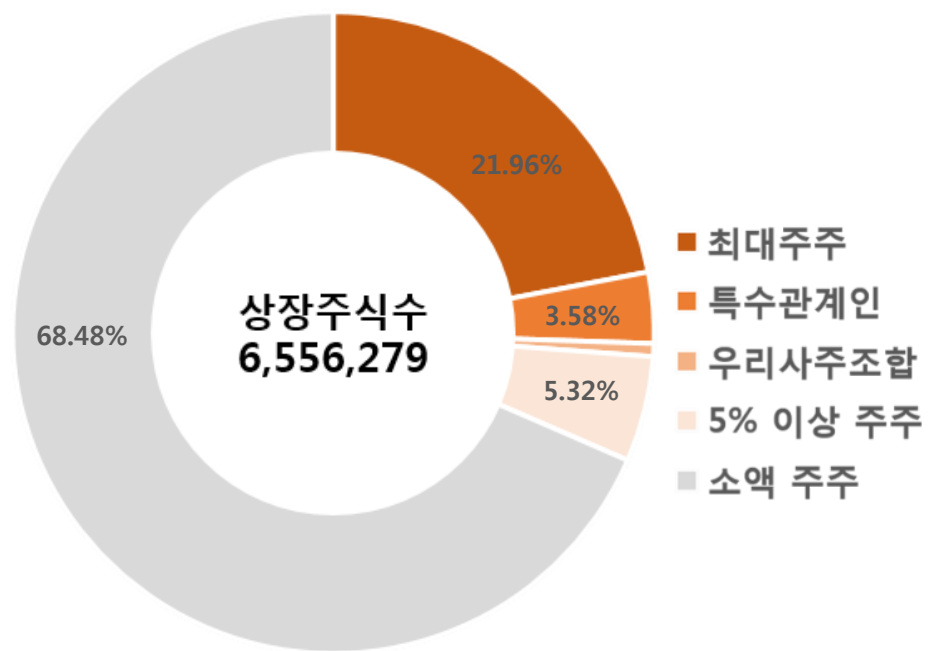
17,282

2002~2018
매출액 연평균성장률(CAGR)

46%

(매출액 단위: 백만원)

Stock Information



구분	종류	주식수(주)	비율(%)	비고
최대주주	보통주	1,440,000	21.96	
특수관계인	보통주	234,443	3.58	
5% 이상	보통주	348,947	5.32	개인
우리사주조합	보통주	42,895	0.65	
소액 주주	보통주	4,489,994	68.48	-

2019. 4. 24. 기준

Contents



Company Information

Business Information

- ✓ Core Technology
- ✓ Business Overview
- ✓ Products Information
- ✓ Opportunity: 5G
- ✓ Opportunity: New Customer
- ✓ Opportunity: REP 필요성 확대
- ✓ Business Roadmap: REP
- ✓ Business Roadmap: MCP
- ✓ Business Roadmap: Automotive

Financial Information

Core Technology

Over 20 years' LTCC Technologies



구분	일반 PCB	MCP	
소재	FR4	Ceramic	
크기	> 12 inch	< 12 inch	대면적화 가능
강도	-	350MPa	고강도
내열성	< 200°C	< 800°C	4배 우수

구분	일반 PCB	MCP	
Dielectric Loss	2×10^{-2}	1×10^{-3}	20배 우수
열전도도	0.3W/mK	3.0W/mK	10배 우수
열팽창 계수	17ppm/°C	4ppm/°C	Si 정합성
절연 전압	25kV/mm	25kV/mm	동등

Business Overview

세라믹 원천 소재기술 기반 LTCC 소재, 이동통신용 부품 및 세라믹 PCB 제조



Products Information

RN2 Products

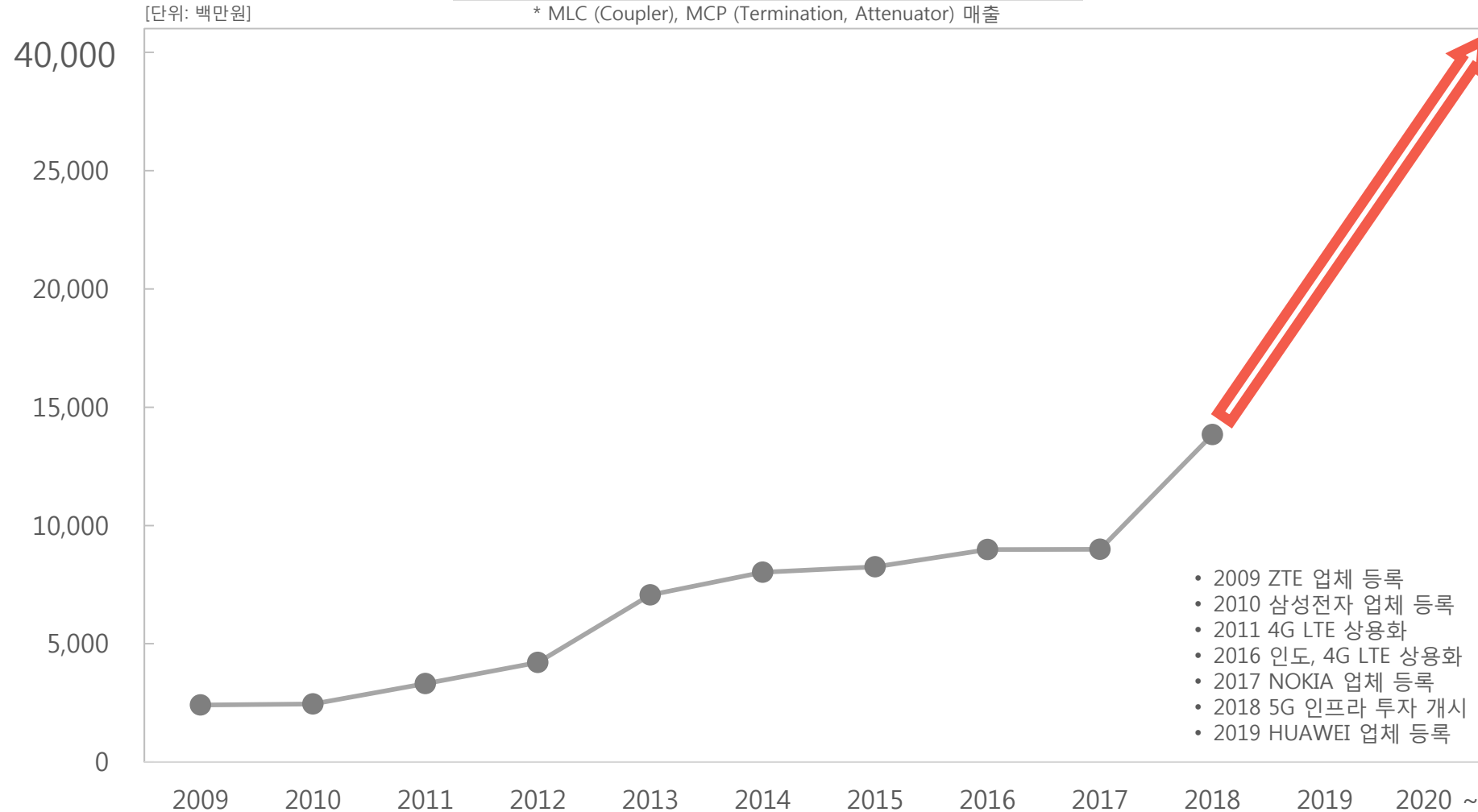
Applications

Customers

MLC	Coupler Quadrifilar Doherty Combiner Delay Line		무선통신 중계기	5G & 4G	  
	Termination Attenuator			M-MIMO	
MCP	CMOS Sensor Packaging 기판 F/S		X-ray Detectors 방위산업	Small Cells	
	REP (Resistor Embedded Protector)			• Dental/Surgical • Animals • Industrial	  
			2차 전지 보호회로	• Mobile Device • Consumer Elec. • e-Mobility	    
Material	LTCC Powder		무선통신 부품	RF BPF (Band Pass Filter)	  

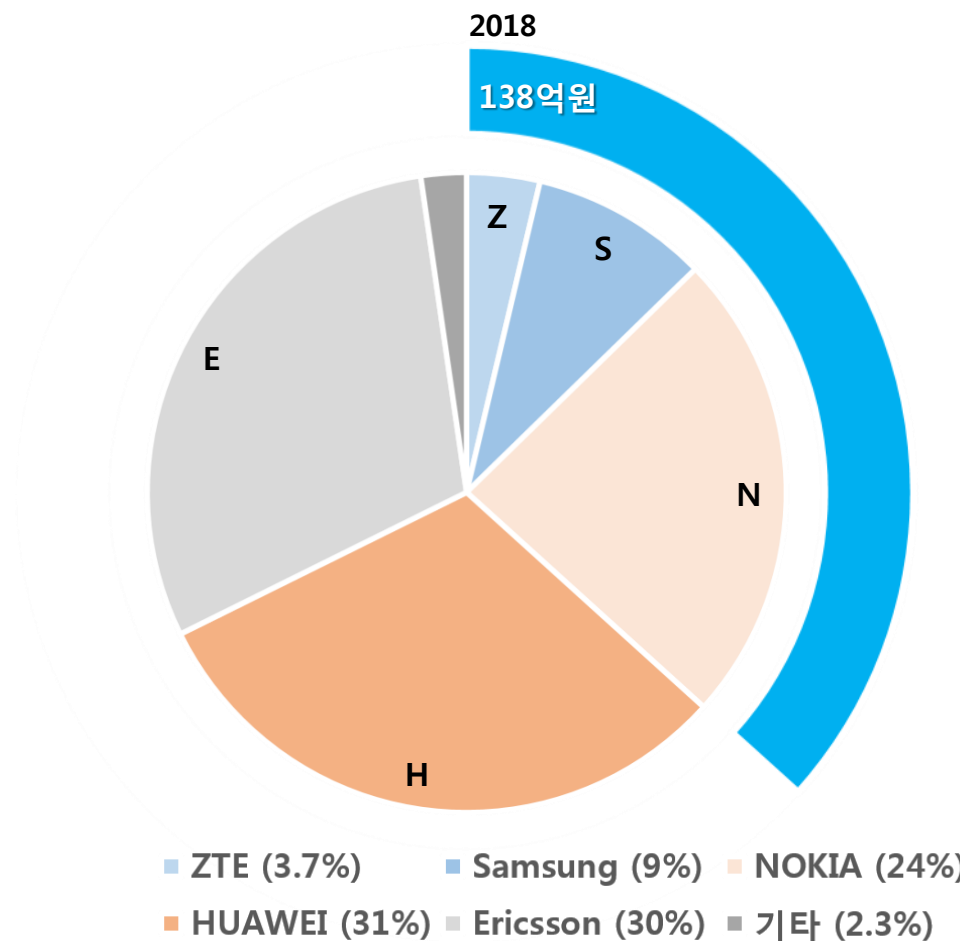
Opportunity: 5G

무선통신 중계기용 부품 매출 추이

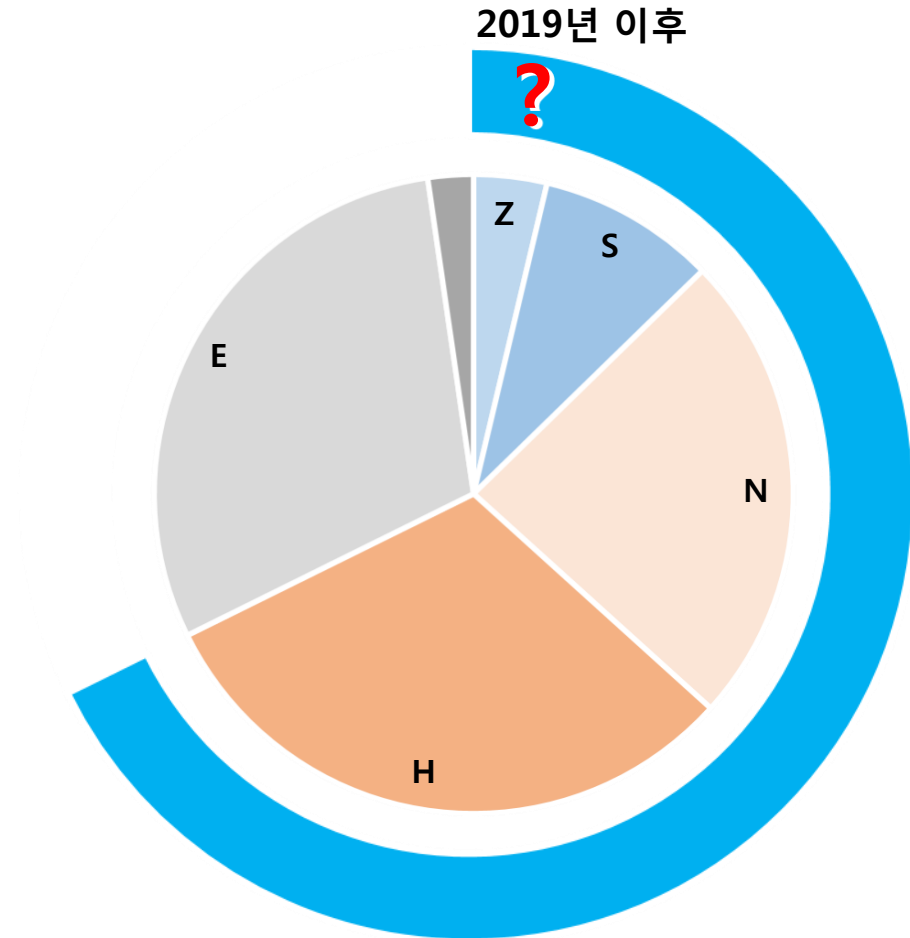


Opportunity: New Customer

•무선통신 장비업체 글로벌 시장점유율 대비 RN2 매출(무선통신 중계기용 부품)



* 무선통신 장비업체 글로벌 시장점유율(2018년 상반기 기준)

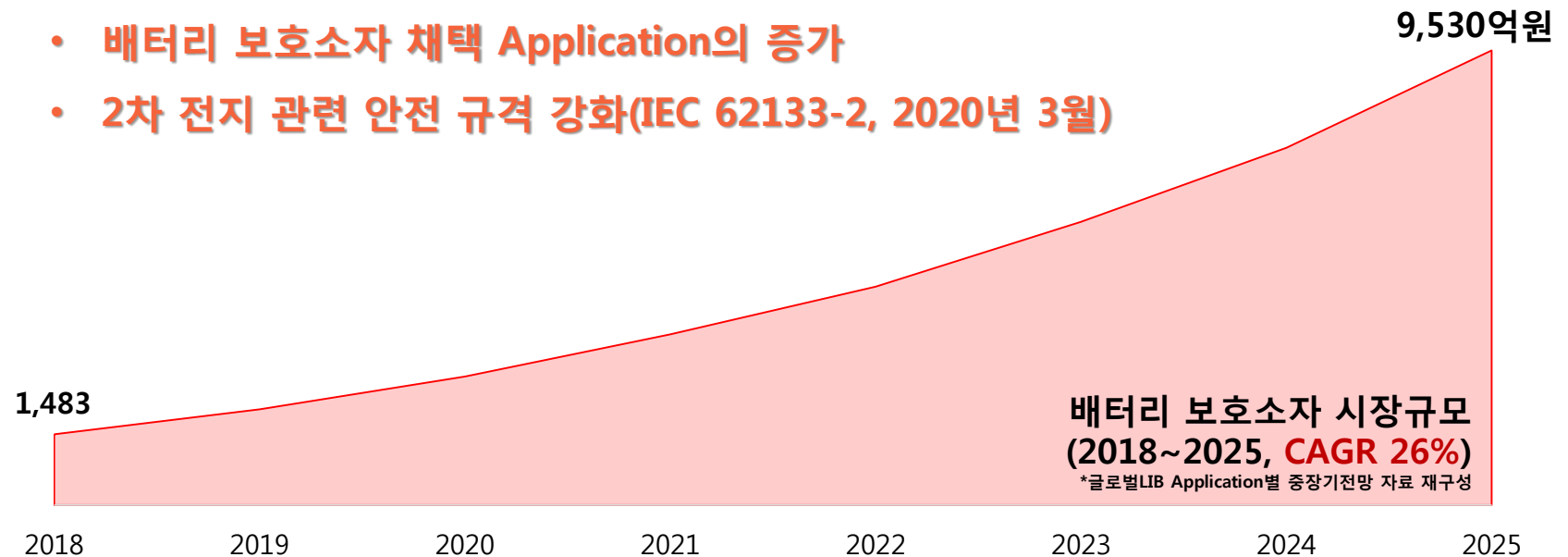


Opportunity: REP 필요성 확대

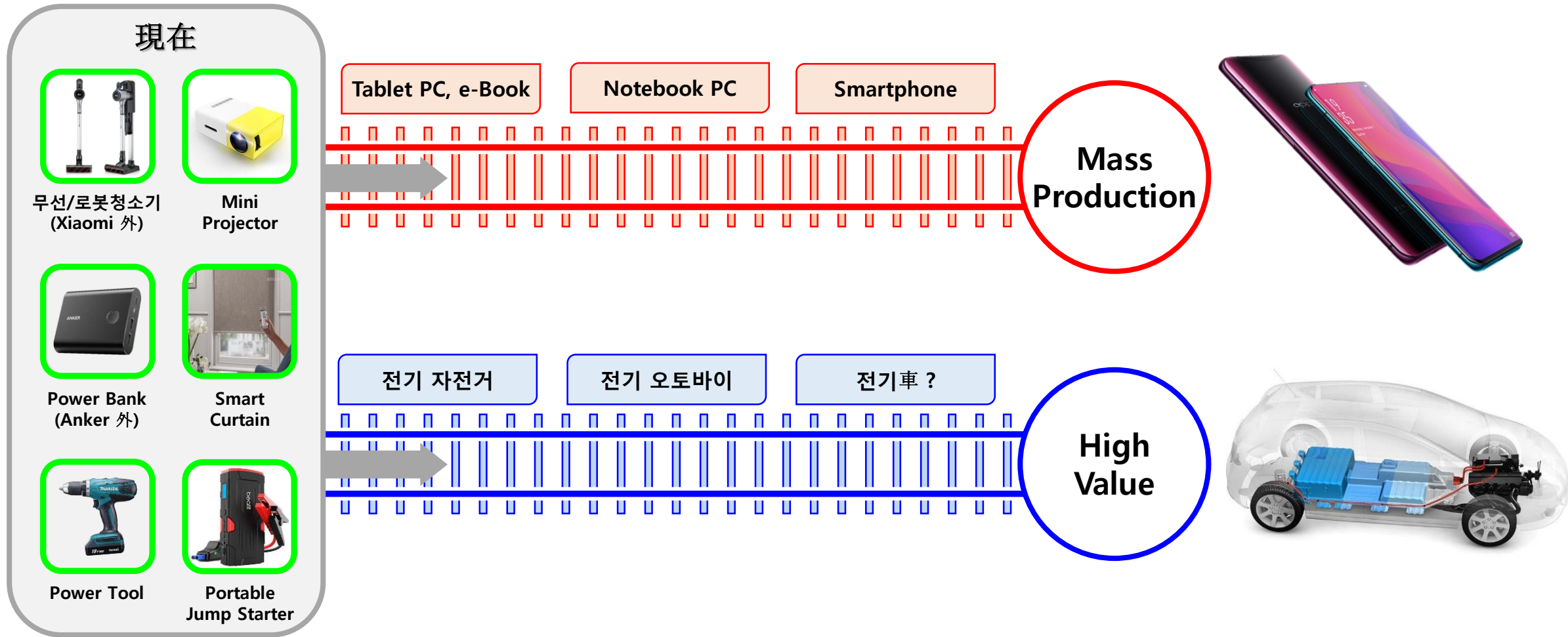
Safety Issue



- 배터리 보호소자 채택 Application의 증가
- 2차 전지 관련 안전 규격 강화(IEC 62133-2, 2020년 3월)



Business Roadmap: REP

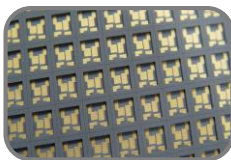


Business Roadmap: MCP

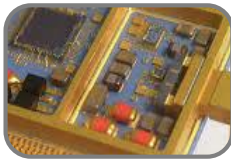
Current Technical Steps

CMOS Sensor Packaging Substrate		대면적·高다층 기판 제조기술
Termination Attenuator		Printed Resistor, Lead 형성 기술
REP (Resistor Embedded Protector)		Embedded Resistor, SMT Entry 기술
Foundry Service		Cavity 제조기술

Next Step



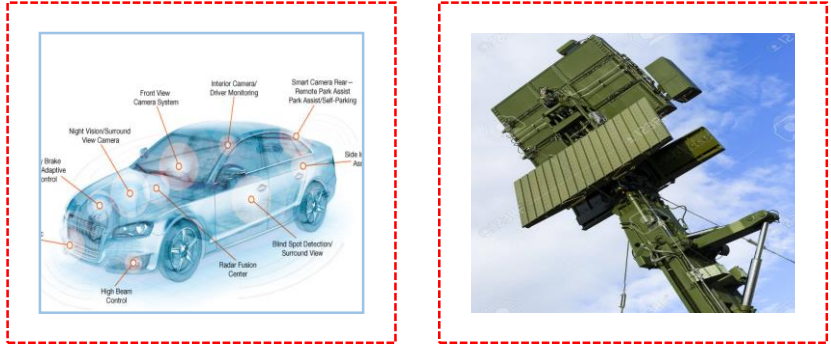
Multi-Cavity



Brazing

- Finer Process
 - Printing, Via, Align
- New Process
 - Side Termination
- SMT-Packaging
 - Multi-Cavity, Brazing

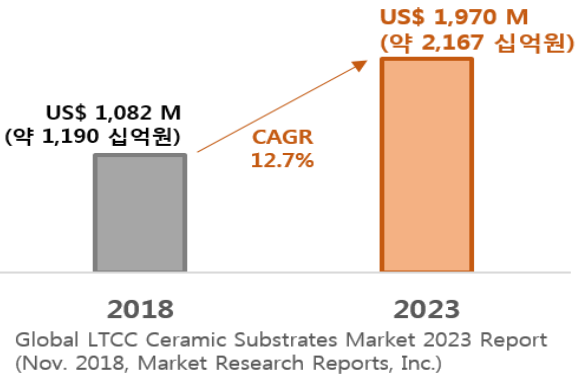
Target Market



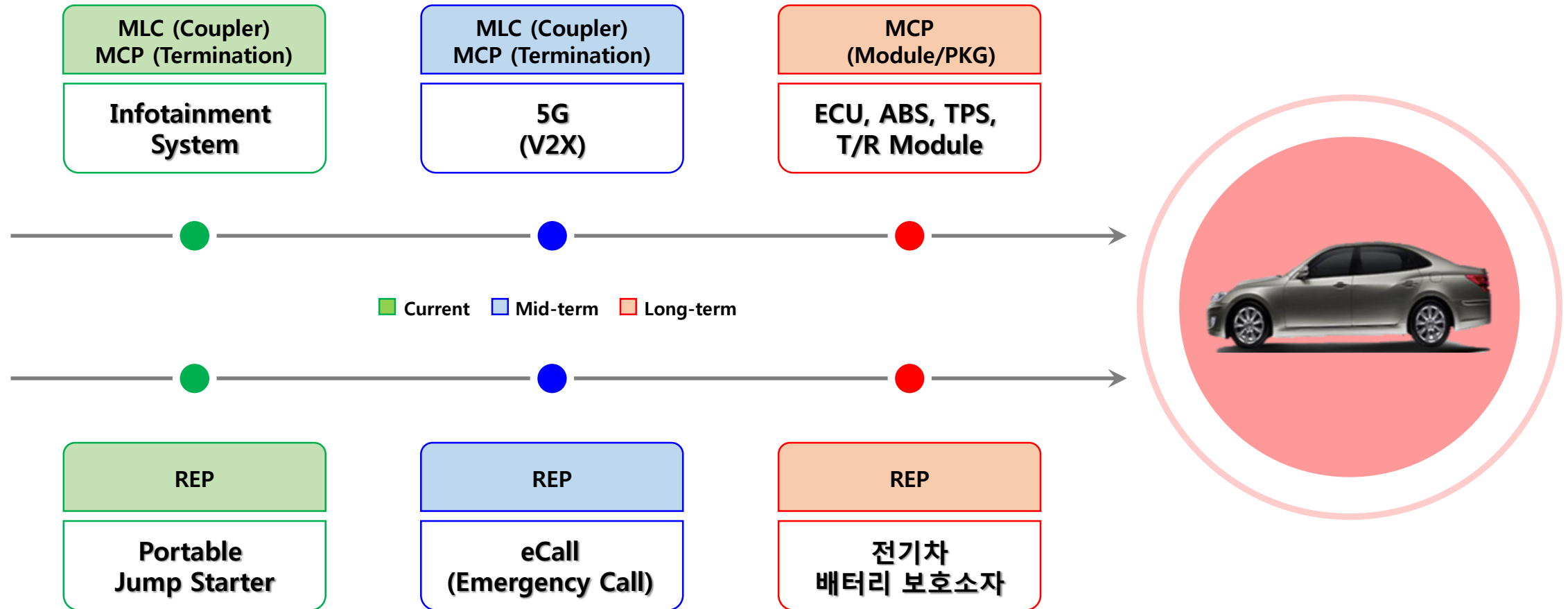
자동차

방위산업

LTCC Market Forecast



Business Roadmap: Automotive



Contents



Company Information

Business Information

Financial Information

- ✓ 요약 재무제표
- ✓ 매출 실적

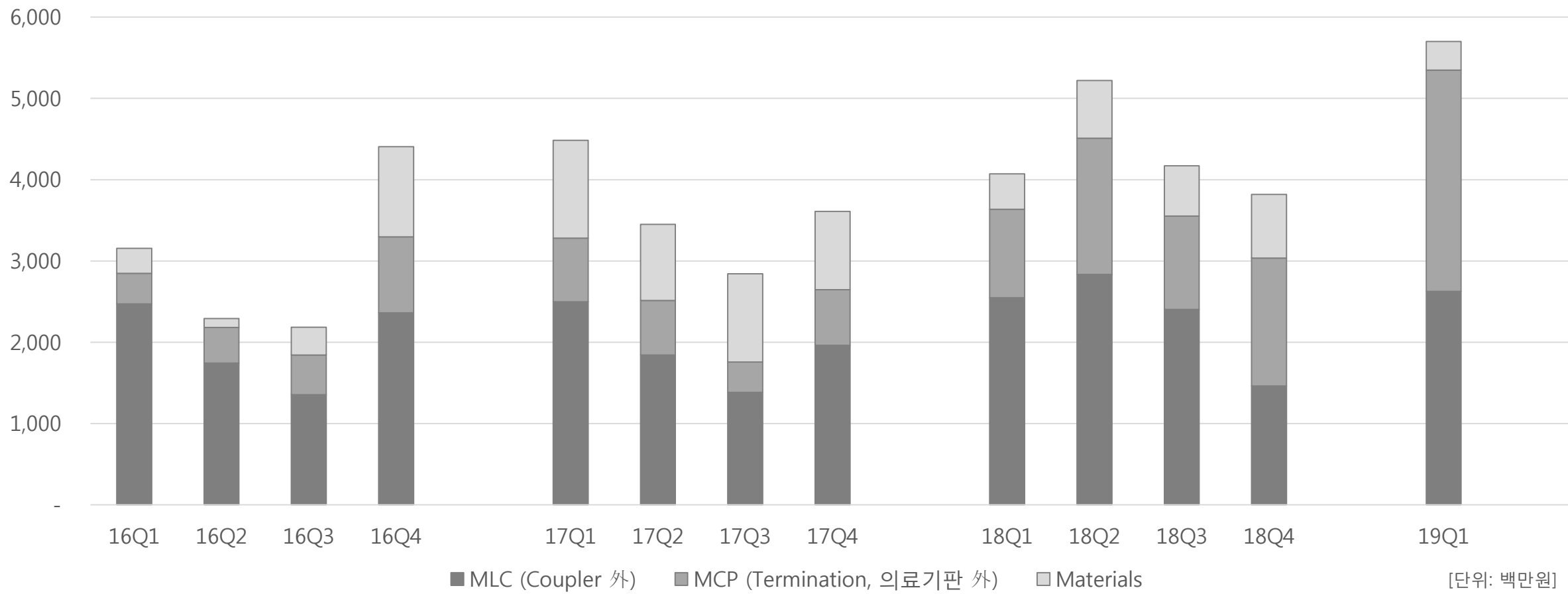
요약 재무제표

	2017	2018	2019Q1
유동자산	17,332	14,359	15,962
비유동자산	18,118	24,509	24,630
자산 총계	35,450	38,868	40,592
유동부채	3,269	3,327	4,248
비유동부채	10,748	13,428	12,283
부채 총계	14,017	16,755	16,531
자본금	3,165	3,165	3,249
자본잉여금	7,256	7,256	8,921
이익잉여금	11,012	11,692	11,891
자본 총계	21,433	22,113	24,061

	2017	2018	2019Q1
매출액	14,391	17,282	5,700
매출원가	9,042	9,414	2,598
매출총이익	5,349	7,868	3,102
판관비와관리비	4,635	6,325	1,947
영업이익	714	1,543	1,155
영업외수익	340	432	190
영업외비용	422	1,092	837 ¹⁾
법인세차감전 순이익	632	883	508
법인세비용(수익)	(145)	(82)	56
당기순이익	777	965	452

1) 파생상품(CB)평가손실 671백만원 반영

매출 실적



Disclaimer

본 자료에 포함된 (주)알엔투 테크놀로지(이하 '회사')의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 기업회계기준 및 한국채택 국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

본 자료는 향후 매출계획 등 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.

이는 과거가 아닌 미래의 추정에 기인하여 성장 가능한 목표치를 경영실적으로 반영하고 있으며, '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 용어를 사용하였습니다.

위 '예측정보'는 경영환경의 변화에 따라 적지 않은 영향을 받을 수 있으며,

이러한 불확실성에 따른 현상은 미래의 경영실적과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 각종 지표들은 현재의 시장상황과 회사의 경영목표 및 방침을 고려하여 작성된 것으로

시장환경의 급속한 변화 및 투자환경, 회사의 전략적 목표 수정에 의하여 그 결과가 다르게 나타날 수 있습니다.

따라서, 투자자는 투자 판단을 내리기에 앞서 반드시 회사의 공시사항을 확인하여야 하며,

본 자료에 열거한 사항은 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 효과를 미치지 못하므로 법적 책임이 없습니다.



2019 Investor Presentation

본사/제1공장/기업부설연구소
경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11
031-376-5400

제2공장/신소재연구소
강원도 강릉시 과학단지로 106-4
033-646-4161

www.RN2.co.kr